
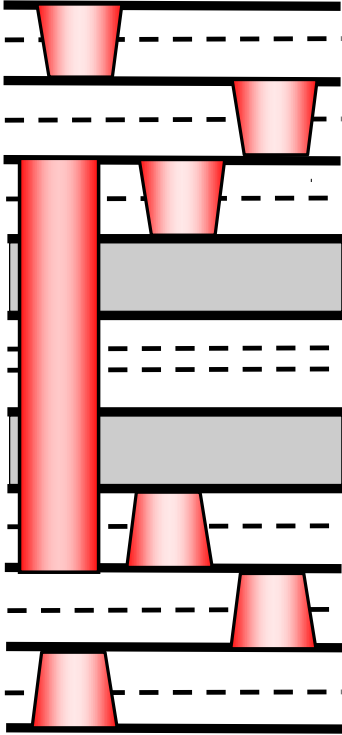


LAGENAUFBAU HDI (Standard)					 vorl. nur CBT Schopfheim						
HDI10_3+4(6b)+3_1,50_35		10 - Lagen Kerne: 0,36 mm Cu 35/35 µm									
WE-Artikel Nr.:		3 + 4(6B) + 3									
KUNDE:											
LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU			BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG		
KUNDE	WE							[µm]	[µm]		
1	TOP/VS				Folie	12 µm	1)	12			
									1 x 1080	60	
2	VSK2				Folie	12 µm		30			
									1 x 1080	60	
3	VSK1				Folie	12 µm		35			
									1 x 1080	60	
4	2					35 µm		33			
					0,360 mm			360			
5	3					35 µm		33			
						2 x 1080	124				
6	4		35 µm		33						
		0,360 mm			360						
7	5		35 µm		33						
						1 x 1080	60				
8	RSK1		12 µm		35						
						1 x 1080	60				
9	RSK2	Folie	12 µm		30						
						1 x 1080	60				
10	BOT/RS	Folie	12 µm	1)	12						
					1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm						
					Gesamtdicke Material: 1490						
					Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)						
MATERIALDICKE:		1,50	+/-	0,13	mm	Datum:		Bearbeiter:			
DICKE über galv. Endoberfläche		1,59	+/-	0,16	mm						
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer		1,65	+/-	0,18	mm						
Kundenforderung:			+/-		mm	Messstelle:					
Erstellt am		von		Geprüft am		von		Freigegeben am			
28.03.2006		S.Keller		04.05.2006		M.Kress		04.05.2006			
								Revision			
								00			
								Seite: 21+			